

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2020年10月1日(01.10.2020)



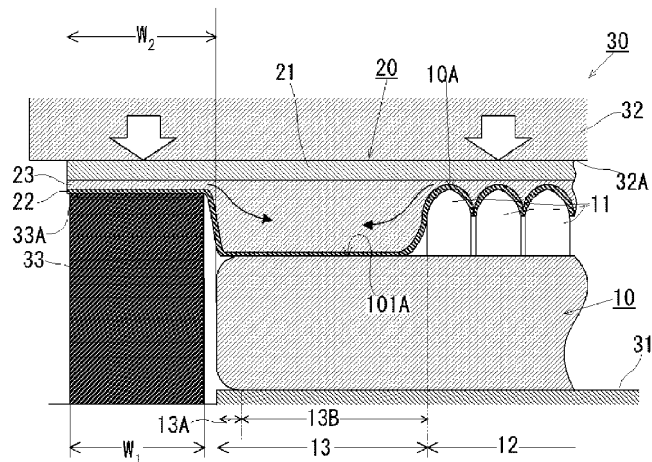
(10) 国際公開番号

WO 2020/196794 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/304 (2006.01) C09J 7/29 (2018.01)
H01L 21/683 (2006.01) C09J 7/38 (2018.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2020/013846
- (22) 国際出願日: 2020年3月26日(26.03.2020)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2019-061828 2019年3月27日(27.03.2019) JP
- (71) 出願人: 三井化学東セロ株式会社
(MITSUI CHEMICALS TOHCELLO, INC.) [JP/
JP]; 〒1018485 東京都千代田区神田美
土代町7 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 野上 昌男(NOGAMI Masao); 〒4570801
愛知県名古屋市南区丹後通2-1 三井
化学東セロ株式会社内 Aichi (JP). 森本 哲
光(MORIMOTO Akimitsu); 〒1018485 東京都
千代田区神田美土代町7 三井化学東セ
ロ株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 鈴木 勝雅 (SUZUKI Katsumasa);
〒4560031 愛知県名古屋市熱田区神宮三丁目8
番20号 神宮東熱田ビル4階 Aichi (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ,
BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,
HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH,

(54) Title: PROTECTION FILM, METHOD FOR AFFIXING SAME, AND METHOD FOR MANUFACTURING SEMICONDUCTOR COMPONENT

(54) 発明の名称: 保護フィルム及びその貼着方法並びに半導体部品の製造方法



(57) Abstract: Provided are a protection film affixing method, a semiconductor component manufacturing method, and a protection film used for an affixing method with which make it possible to suppress generation of troubles caused by a height difference in a main surface of a semiconductor wafer. The affixing method comprises an arranging step for arranging a protection film 20 so as to cover a main surface 10A of a semiconductor wafer 10, and an affixing step for affixing the protection film 20 by pressing the protection film 20 onto the main surface 10A. The main surface 10A includes a first region 12 in which bumps 11 are provided, and a second region 13 which includes at least a part of a periphery of the main surface 10A and in which the bumps 11 are not provided. The affixing step includes a compressing step for compressing the protection film 20 in a thickness direction thereof. The compressing step is performed using a pressing member 32 for pressing the protection film 20 onto the main surface 10A, and a support member 33 installed

[続葉有]

KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,
MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告 (条約第21条(3))

along an outer periphery of the second region 13.

(57) 要約: 半導体ウエハの主面の段差に起因する不具合の発生を抑制することができる保護フィルムの貼着方法、半導体部品の製造方法、貼着方法で利用する保護フィルムを提供するものであり、貼着方法は、半導体ウエハ10の主面10Aを覆うように保護フィルム20を配する配置工程と、保護フィルム20を主面10Aに押し付けて貼着する貼着工程と、を備え、主面10Aは、バンプ11が配された第1領域12と、主面10Aの周縁の少なくとも一部を含む領域であるとともに、バンプ11が配されていない領域である第2領域13と、を有し、貼着工程は、保護フィルム20をその厚さ方向へ圧縮する圧縮工程を含み、圧縮工程は、保護フィルム20を主面10Aへ押し付けるための押圧部材32と、第2領域13の外周縁に沿って設置される支持部材33とを使用して行われる。